



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22760X

Issue Date:26 Feb 2020

Title of Change:	Capacity expansion of Assembly and Test operations of DPAK manufacturing additional site to GEM, China.
Proposed First Ship date:	02 Jun 2020 or earlier if approved by customer.
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < Lisa.Wang@onsemi.com >
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < Lake.Wang@onsemi.com >
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	1st line Plant code "M" for GEM site
Change Category:	Assembly Change, Test Change
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition, Material Change
Sites Affected:	
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
	GEM, China

Description and Purpose:

This notification announces to customers of ON Semiconductor's plan to expand Assembly and Test operations of DPAK Packaged products to an existing external manufacturing site in GEM china. This is a capacity expansion, at the end of the FPCN approval cycle, these products may be dual sourced from either GEM, China or from On Semi Suzhou, China.

GEM is currently running production for DPAK package. Qualification tests are designed to show that the reliability of the transferred devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standards.

	Before Change Description	After Change Description	
Mold Compound	Sumitomo: EME 6600CS; KCC: KTMCS900GM, KTMCS5400SM Hitachi: CEL8240HF10FC	Sumitomo: EME 6600CS; KCC: KTMCS900GM, KTMCS5400SM Hitachi: CEL8240HF10FC	Hitachi: CEL8240HF10FC
Assembly and Test Site	ON Semiconductor Suzhou	ON Semiconductor Suzhou	GEM, China
Product marking change	1 st line plant code "1"	1 st line plant code "1"	1 st line plant code "M"



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: FQD2N100TM-F101

RMS# : U61203

PACKAGE : TO-252

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_% max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL __1__ @ __260__ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15

QV DEVICE NAME: FCD850N80Z

RMS# : V57582

PACKAGE : TO-252

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_% max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL __1__ @ __260__ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22760X

Issue Date:26 Feb 2020

QV DEVICE NAME: FDD5N50FTM-WS

RMS# : U61208

PACKAGE : TO-252

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH	264 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/77

QV DEVICE NAME: FDD8647L

RMS# : U61207

PACKAGE : TO-252

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH	264 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/77



QV DEVICE NAME: FQD18N20V2TM

RMS# : U61206

PACKAGE : TO-252

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hr	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hr	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hr	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL __1__ @ __260__ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15

QV DEVICE NAME: FDD4N60NZ

RMS# : V61212

PACKAGE : TO-252

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL __1__ @ __260__ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15



QV DEVICE NAME: FDD390N15ALZ

RMS# : V61199

PACKAGE : TO-252

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
FQD3P50TM-AM002BLT	FQD2N100TM-F101
FQD4P40TM	FQD2N100TM-F101
FQD5N15TM	FQD2N100TM-F101
FQD7N30TM	FQD2N100TM-F101
FQD18N20V2TM	FQD18N20V2TM
FCD1300N80Z	FCD850N80Z
FCD2250N80Z	FCD850N80Z
FDD3N50NZTM	FDD5N50UTM-WS



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22760X

Issue Date:26 Feb 2020

FDD4N60NZ	FDD4N60NZ
FDD5N50NZFTM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N60NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD8N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
SSR1N60BTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD3N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD5N50CTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD5N60CTM	FQD2N100TM-F101
FQD5N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD6N50CTM	FQD18N20V2TM
FQD6N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FDD1600N10ALZ	FDD390N15ALZ
FDD390N15A	FDD390N15ALZ
FDD390N15ALZ	FDD390N15ALZ
FDD86110	FDD390N15ALZ
FDD86250	FDD390N15ALZ
FDD86252	FDD390N15ALZ
FDD86326	FDD390N15ALZ
FDD3860	FDD8647L
FDD5353	FDD8647L
FDD8444	FDD8647L
FDD8451	FDD8647L
FDD8453LZ	FDD8647L
FDD8647L	FDD8647L
FQD1N80TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N100TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N80TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N90TM	FQD2N100TM-F101
FQD30N06TM	FQD2N100TM-F101
FQD3P50TM	FQD2N100TM-F101
FCD3400N80Z	FCD850N80Z
FCD380N60E	FCD850N80Z
FCD600N60Z	FCD850N80Z



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22760X

Issue Date:26 Feb 2020

FCD620N60ZF	FCD850N80Z
FCD850N80Z	FCD850N80Z
FCD900N60Z	FCD850N80Z
FCD9N60NTM	FCD850N80Z
FDD2572	FDD5N50UTM-WS
FDD2582	FDD5N50UTM-WS
FDD3672	FDD4N60NZ
FDD3682	FDD4N60NZ
FDD10N20LZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD18N20LZ	FDD5N50UTM-WS
FDD3N40TM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50FTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50UTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD6N20TM	FDD5N50UTM-WS
FDD6N25TM	FDD5N50UTM-WS
FDD7N20TM	FDD5N50UTM-WS
FDD7N25LZTM	FDD5N50UTM-WS

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22760X

発行日: 26 Feb 2020

変更件名:	DPAK 製造における組立および検査オペレーションの追加拠点として GEM (中国) を認定して生産能力を拡大		
初回出荷予定日:	02 Jun 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Lisa.Wang@onsemi.com> にお問い合わせください。		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。		
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <Lake.Wang@onsemi.com> にお問い合わせください。		
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。		
変更部品の識別:	1 行目の工場コードが、GEM 拠点は「M」になります		
変更カテゴリ: アセンブリの変更, 試験の変更			
変更サブカテゴリ: 製造拠点の追加, 材料の変更			
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:		
	GEM, China		
説明および目的:			
本通知は、DPAK パッケージ製品の組立と検査オペレーションの能力を GEM (中国) の既存の外部製造拠点に拡大するオン・セミコンダクターの計画を、お客様にお知らせするものです。これにより生産能力が拡大し、FPCN 承認サイクルが完了した時点で、対象製品は、GEM (中国) またはオン・セミコンダクター蘇州 (中国) のいずれかから供給されるデュアルソースになります。 GEM は現在 DPAK パッケージの製造をしています。認定試験は、移管された製品の信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを証明するように設計されています。			
	変更前の表記	変更後の表記	
モールド・コンパウンド	Sumitomo: EME 6600CS; KCC: KTMCS5900GM, KTMCS5400SM Hitachi: CEL8240HF10FC	Sumitomo: EME 6600CS; KCC: KTMCS5900GM, KTMCS5400SM Hitachi: CEL8240HF10FC	Hitachi: CEL8240HF10FC
組立拠点および 検査拠点	ON Semiconductor Suzhou	ON Semiconductor Suzhou	GEM, China
製品マーキング変更	1 st line plant code "1"	1 st line plant code "1"	1 st line plant code "M"



信頼性データの要約:

デバイス名: FQD2N100TM-F101

RMS# : U61203

パッケージ : TO-252

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -_55_ °C to +_150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15

デバイス名: FCD850N80Z

RMS# : V57582

パッケージ : TO-252

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -_55_ °C to +_150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15



デバイス名: FQD2N100TM-F101

RMS# : U61203

パッケージ: TO-252

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH	264 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/77

デバイス名: FDD8647L

RMS# : U61207

パッケージ: TO-252

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH	264 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/77



デバイス名: FQD18N20V2TM

RMS# : U61206

パッケージ: TO-252

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hr	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hr	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hr	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15

デバイス名: FDD4N60NZ

RMS# : V61212

パッケージ: TO-252

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1000 cyc	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1008 hrs	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22760X

発行日: 26 Feb 2020

デバイス名: FDD390N15ALZ

RMS# : V61199

パッケージ: TO-252

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, _80_ % max rated V	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	Ta= _150_ °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= _150_	1008 hrs	0/77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = _2_ min	15k cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= - _55_ °C to + _150_ °C	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, 18.8psig, bias	1000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL _1_ @ _260_ °C		
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FQD4P40TM	FQD2N100TM-F101
FQD5N15TM	FQD2N100TM-F101
FQD7N30TM	FQD2N100TM-F101
FQD18N20V2TM	FQD18N20V2TM
FCD1300N80Z	FCD850N80Z
FCD2250N80Z	FCD850N80Z
FDD3N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD4N60NZ	FDD4N60NZ
FDD5N50NZFTM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50NZTM	FDD5N50UTM-WS



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22760X

発行日: 26 Feb 2020

FDD5N60NZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD8N50NZTM	FDD5N50UTM-WS
SSR1N60BTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD3N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD5N50CTM-WS	FQD18N20V2TM
FQD5N60CTM	FQD2N100TM-F101
FQD5N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FQD6N50CTM	FQD18N20V2TM
FQD6N60CTM-WS	FQD2N100TM-F101
FDD1600N10ALZ	FDD390N15ALZ
FDD390N15A	FDD390N15ALZ
FDD390N15ALZ	FDD390N15ALZ
FDD86110	FDD390N15ALZ
FDD86250	FDD390N15ALZ
FDD86252	FDD390N15ALZ
FDD86326	FDD390N15ALZ
FDD3860	FDD8647L
FDD5353	FDD8647L
FDD8444	FDD8647L
FDD8451	FDD8647L
FDD8453LZ	FDD8647L
FDD8647L	FDD8647L
FQD1N80TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N100TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N80TM	FQD2N100TM-F101
FQD2N90TM	FQD2N100TM-F101
FQD30N06TM	FQD2N100TM-F101
FQD3P50TM	FQD2N100TM-F101
FCD3400N80Z	FCD850N80Z
FCD380N60E	FCD850N80Z
FCD600N60Z	FCD850N80Z
FCD620N60ZF	FCD850N80Z
FCD850N80Z	FCD850N80Z
FCD900N60Z	FCD850N80Z
FCD9N60NTM	FCD850N80Z
FDD2572	FDD5N50UTM-WS



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN22760X

発行日 : 26 Feb 2020

FDD2582	FDD5N50UTM-WS
FDD3672	FDD4N60NZ
FDD3682	FDD4N60NZ
FDD10N20LZTM	FDD5N50UTM-WS
FDD18N20LZ	FDD5N50UTM-WS
FDD3N40TM	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50FTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD5N50UTM-WS	FDD5N50UTM-WS
FDD6N20TM	FDD5N50UTM-WS
FDD6N25TM	FDD5N50UTM-WS
FDD7N20TM	FDD5N50UTM-WS
FQD3P50TM-AM002BLT	FQD2N100TM-F101
FDD7N25LZTM	FDD5N50UTM-WS